

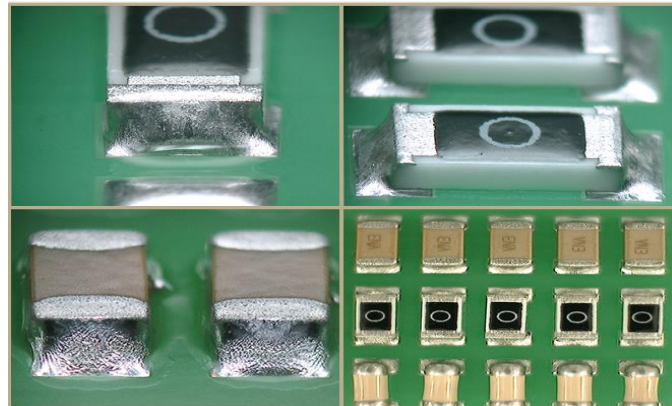
PASTA PARA SOLDAR QUE NO NECESITA LIMPIEZA NC258

CARACTERÍSTICAS

- Grandes capacidades de pausar para imprimir
- Excelente humectación, incluso en dispositivos sin plomo
- Reduce la formación de vacíos
- Pocos residuos después del proceso
- Cumple con RoHS
- Aprueba la prueba Bono

DESCRIPCIÓN

NC258 fue desarrollado para ofrecer grandes capacidades de pausar para imprimir al mismo tiempo que mejora las definiciones de las impresiones pequeñas. NC258 reduce la formación de vacíos. La capacidad de humectación superior de NC258 brinda uniones de soldadura brillantes, lisas y lustrosas. También genera muy pocos residuos después del proceso, que siguen siendo transparentes incluso a las temperaturas elevadas requeridas en la actualidad para aleaciones sin plomo.



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Hora	Temperatura
Vida en almacenamiento sellado	1 año	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida en almacenamiento abierto	3 meses	< 25°C (< 77°F)

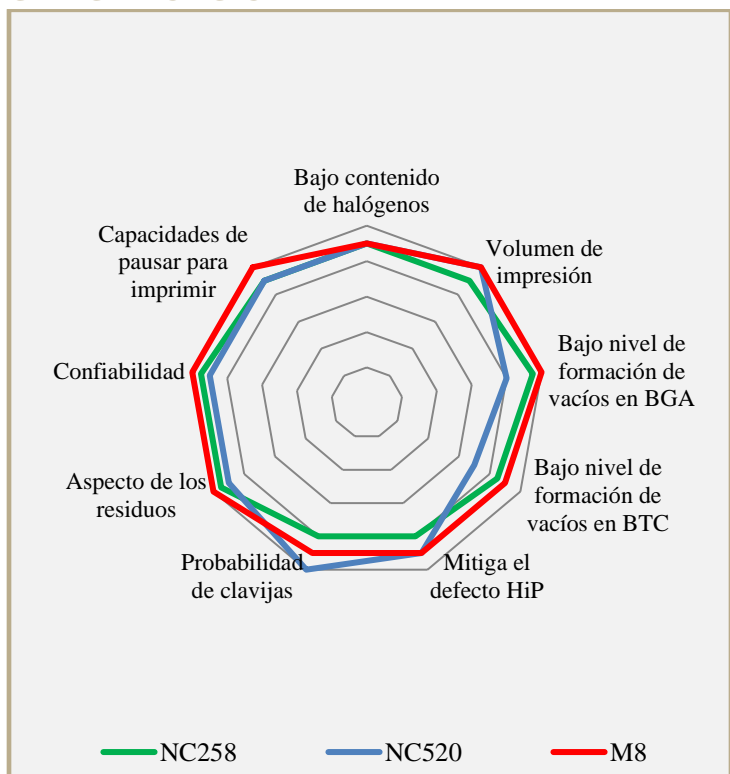
No agregar pasta usada a pasta sin usar. Almacenar la pasta usada por separado; mantener la pasta sin usar sellada herméticamente con un tapón interno o tapa de extremo colocados. Consultar las pautas de la pasta de AIM para obtener más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de NC258 para información específica del producto.

LIMPIEZA

Antes del reflujo: DJAW-10 de AIM elimina con eficacia la pasta para soldadura NC258 de plantillas durante el proceso. Se puede aplicar DJAW-10 manualmente o usarse debajo del equipo de limpieza de las plantillas. DJAW-10 no secará la pasta NC258 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 a la parte superior de las plantillas. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede usar como enjuague final de las plantillas.

Residuo de fundente después del reflujo: Los residuos de NC258 pueden permanecer en el conjunto después del reflujo y no requieren limpieza. Para cuando sea obligatorio limpiar, AIM trabajó estrechamente con socios de la industria para asegurarse de que los residuos de NC258 se puedan eliminar con eficacia con agentes removedores de fundente comunes. Comuníquese con AIM para obtener información sobre la compatibilidad de limpieza.

CARACTERÍSTICAS



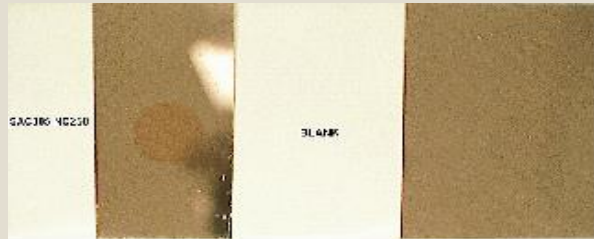


PERFIL DE REFLUJO


Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.


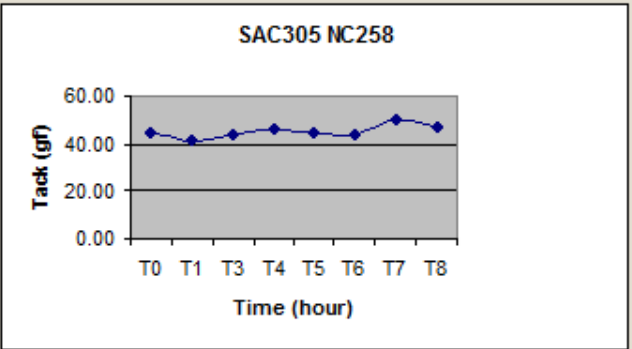
IMPRESIÓN

Los Ajustes Iniciales Abajo Recomendados Son Dependientes Del Diseño Del PCB Y PAD	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de la Boquilla	0.9 – 1.5 lbs/ pulgada de la navaja
Velocidad de la Boquilla	0.5 – 6 pulgada/segundo
Distancia de Desprendimiento	Al contacto 0.00mm (0.00’’)
Distancia de Separación del PCB	0.75 – 2.0mm (.038 - .080’’)
Velocidad de Separación del PCB	3.0 – 20.00 mm/ segundo

DATOS DE PRUEBA

Nombre	Método de Prueba	Resultados	
Clasificación IPC	J-STD-004	ROLO	
Clasificación IPC	J-STD-004B 3.3.1	ROL1	
Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antes</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Después</p>  </div> </div>

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Haluros cuantitativos	J-STD-004 3.2.4.3.1 IPC-TM-650 2.3.35 or 28	Br: 0.33% Cl: 0%	
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASA	Sin Fluoruro
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	Resultados disponibles a pedido (See Aim Qualification Test Report #NC258052510)
Prueba Bono		PASA Fc<8.0 Tipico	
Bomba de Oxígeno Pruebas de halógenos	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Br <50.1 mg/Kg Cl <125 mg/Kg	
Migración electroquímica	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASA	
Sólidos del fundente, determinación de no volátiles	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	99.9% Tipico	
Valor Ácido Determination	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	145 +/- 6mg KOH/g Flux Tipico	
Gravedad específica del flux	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.92 Tipico	
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	600-900 Dependiendo de la carga de metal y tamaño de las partículas	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASA	

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Prueba de Slump de la Soldadura en Pasta	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	 <p>15Min 4Hr</p>
Fuerza de Adhesion	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	37.9g Tipico	 <p>SAC305 NC258</p> <p>Tack (gf)</p> <p>Time (hour)</p>
Prueba de Wetting	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA	